**[富满微杯](http://univ.ciciec.com/nd.jsp?id=566" \l "_jcp=1)**

**一、杯赛题目：芯片设计创新成果**

**二、参赛要求：A组、B组**

**三、赛题内容：**

1. 参赛项目的主体部分为一个或多个具备特定功能的芯片或IP设计成果。芯片类型，应用场景，制造工艺以及使用功能不限，但应当在技术上具备创新性，或在应用上具备市场价值；

2. 芯片设计成果技术指标不限，要求与所对应的功能匹配；

3. 要求完成从算法，电路，仿真，版图，验证等全流程设计，完成流片测试或者芯片应用系统验证者加分。如为项目需要，可以采用FPGA验证；

4. 参赛团队成员应当主导或深入参与了本参赛芯片设计成果的开发，参赛经过了本芯片成果所有方的授权；

**四、杯赛阶段及提交内容：**

1. 中期汇报

        提交简短的项目内容和进展说明，应当包括创新成果简介，主要技术指标和应用领域，以及当前开发进度等；

2. 初赛和企业初评

(1) 成果技术报告（必须）：

        包含芯片设计创新成果的系统架构分析、关键技术原理分析以及电路指标要求等

(2) 仿真验证文件(必须)：

        前后仿真结果、原理图、版图及验证文件

(3) 商业计划书（可选）

        如果创新成果已经具备一定的市场化和产品化潜力，推荐撰写商业计划书。可包含如下内容：公司／团队介绍、技术与产品、市场分析、竞争分析、市场营销、投资说明、投资报酬与退出、风险分析、组织管理、经营预测、财务分析等。

3. 分赛区决赛提交

(1) 汇报PPT：包括成果介绍，关键技术分析，性能指标，商业价值分析以及项目进展等；

(2) 技术文档以及设计数据（前后仿真结果、原理图、版图及验证文件）

(3) 成果技术报告（同上）

(4) 商业计划书（同上）

4. 总决赛提交

(1) 同分赛区决赛提交内容。

**五、评分标准**

本杯赛将综合考虑项目的技术创新性和项目市场潜力及可行性，只要项目在两个方面任何一个具备优势，均有机会获得高分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大项 | 内容 | 分值 | 评分要求 |
| 技术方面（60分） | 技术创新性 | 30分 | 技术方向的创新点以及相对同行的领先程度 |
| 项目难度和成熟度 | 15分 | 整个项目的复杂度，工作量以及技术的成熟度 |
| 项目完成度 | 15分 | 是否完成了芯片设计的全流程，以及成果到实现实际应用的距离 |
| 商业方面（30分） | 市场价值 | 15分 | 项目所在赛道的市场规模和项目本身的产业化前景 |
| 投资价值 | 15分 | 项目是否具备竞争优势，带头人及团队的能力，当前知识产权价值等 |
| 现场表现（10分） | 演讲能力 | 5分 | 现场演讲和提问环节的整体表现 |
| 文档质量 | 5分 | 所展示的PPT以及商业计划书项目资料的质量 |

**六、注意事项**

1. 大赛组委会和杯赛企业对参赛作品的提交材料拥有展示权。

2. 本杯赛企业大奖团队有机会参与大赛免费流片项目。

3. 大赛联合投资机构搭建的高校集成电路创新孵化平台将优选出具备技术领先性或市场潜力的优秀项目，给予后续的技术，资金，行业资源和落地支持。